

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji imiennych serii H MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

24-04-2019 12:30:01 | Bieżący | EBI | 17/2019

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii H o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 7 301 000 zł (siedem milionów trzysta jeden tysięcy złotych). O zamiarze emisji obligacji Spółka powiadamiała w raporcie bieżącym EBI nr 12/2019 z 11 marca 2019 r. Przydział nastąpił na rzecz 87 podmiotów (osób fizycznych) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Daniel Pihan - Członek Zarządu

Prezes Zarządu


Mirosław Pasieka

Członek Zarządu


Daniel Pihan